

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2025-075  
**深圳华强实业股份有限公司**  
**关于为控股子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次担保后,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及控股公司对外担保余额为人民币750,600.40万元,占公司最近一期经审计归母净资产的107.88%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 担保人:深圳华强实业股份有限公司

2. 被担保人:公司全资子公司湘海电子(香港)有限公司(以下简称“香港湘海”),华强半导体有限公司(以下简称“香港半导体”),以及公司控股子公司芯语(香港)有限公司(以下简称“香港芯语”),联汇(香港)有限公司(以下简称“香港联汇”),芯斐科技(香港)有限公司(以下简称“芯斐科技”),芯斐电子(香港)有限公司(以下简称“香港芯斐”)

3. 担保基本情况介绍

鉴于公司于2022年11月22日为香港湘海、香港芯语、香港联汇、芯斐科技、香港芯斐向中银香港有限公司(以下简称“中银香港”)申请贷款或授信提供的9,000万美元的担保(以下简称“原担保”),相关担保的具体情况详见公司于2022年11月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。在2025年12月10日前,根据各被担保人(以下统称“联名被担保人”)业务开展的实际需要,公司于2025年12月16日与中银香港重新签订了《保证合同》,为联名被担保人向中银香港申请单笔金额不超过9,000万美元(以2025年12月16日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价7.0024计算,折合人民币63,541.80万元)的联名授信提供担保(以下简称“本次担保”),担保期限为担保文件生效之日起至被担保的贷款或授信的履行期限届满之日起后三年止,原担保范围内联名被担保人向中银香港申请的单笔金额的贷款或授信纳入本次担保的担保范围。

4. 联名被担保人相关担保情况说明

公司于2023年3月12日召开董事会会议,2023年4月8日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保额度的议案》,预计公司和/或控股子公司自2023年4月8日起至十二个月,为联名被担保人向公司控股子公司向银行申请贷款或授信提供人民币273,000万元的担保额度(以下简称“预计担保额度”),该议案的具体内容详见公司于2023年5月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本次担保后,联名被担保人前述预计担保额度范围内的担保,根据股东大会的授权,公司董事长审批同意,本次担保相关事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

5. 联名被担保人基本情况

(一)湘海电子(香港)有限公司

1.名称:湘海电子(香港)有限公司

2.住所:香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润物流沙田仓库15楼

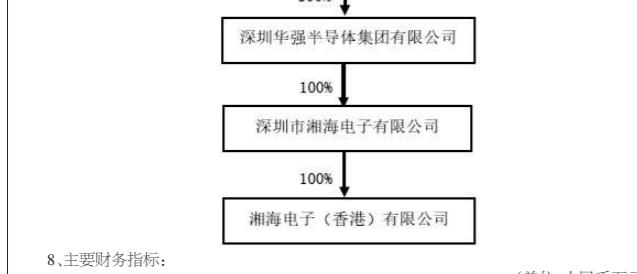
3.成立时间:2012年9月19日

4.主营业务:电子元器件授权分销

5.法定代表人:杨林

6.注册资本:3,220万美元

7.与公司关系:香港湘海为公司全资子公司,与公司关系结构图如下:

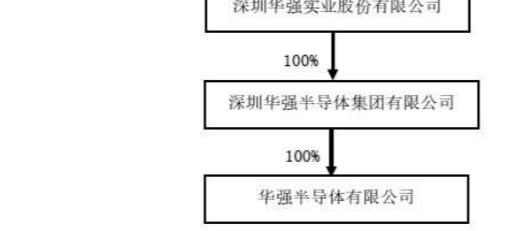


8.主要财务指标:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	295,115.64	401,536.18
负债总额	90,530.10	203,052.91
其中:银行贷款总额	64,162.34	145,869.27
流动负债总额	63,820.40	202,819.01
归属于母公司所有者权益	204,585.53	198,483.27
或有事项涉及的总额	-	-
2025年1月至9月(未经审计)	472,370.06	704,763.59
营业收入	10,634.24	12,427.03
利润总额	8,939.37	10,402.33

9.香港湘海不是失信被执行人,未受到失信惩戒

- (二)华强半导体有限公司  
1.名称:华强半导体有限公司  
2.住所:香港九龙尖沙咀道33号中港城1座1801B室  
3.成立时间:2013年11月8日  
4.主营业务:电子元件器件授权分销  
5.法定代表人:陈辉军  
6.注册资本:6,000万美元  
7.与公司关系:香港半导体为公司全资子公司,与公司关系结构图如下:



8.主要财务指标:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	151,180.96	93,992.47
负债总额	107,753.13	53,359.60
其中:银行贷款总额	24,970.41	2,606.81
流动负债总额	105,106.74	53,359.60
归属于母公司所有者权益	41,639.22	39,225.27
或有事项涉及的总额	-	-
2025年1月至9月(未经审计)	240,425.97	288,761.45
营业收入	5,611.55	8,541.67
利润总额	2,884.66	5,552.69

9.香港半导体不是失信被执行人,未受到失信惩戒

- (三)联汇(香港)有限公司  
1.名称:联汇(香港)有限公司  
2.住所:香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润物流沙田仓库14楼

3.成立时间:2015年8月26日

4.主营业务:电子元件器件授权分销

5.法定代表人:陈辉军

6.注册资本:500万美元

7.与公司关系:芯斐科技为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:



8.主要财务指标:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	74,717.10	70,557.58
负债总额	41,853.71	41,154.81
其中:银行贷款总额	29,549.01	25,247.95
流动负债总额	41,853.71	41,154.81
归属于母公司所有者权益	32,863.39	29,402.78
或有事项涉及的总额	-	-
2025年1月至9月(未经审计)	130,926.70	155,994.35
营业收入	4,559.34	5,297.29
利润总额	3,831.09	4,402.13

9.香港联汇不是失信被执行人,未受到失信惩戒

- (四)芯斐科技(香港)有限公司  
1.名称:芯斐科技(香港)有限公司  
2.住所:香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润物流沙田仓库4楼

3.成立时间:2015年11月10日

4.主营业务:电子元件器件授权分销

5.法定代表人:陈辉军

6.注册资本:100万美元

7.与公司关系:芯斐科技为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:



8.主要财务指标:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	86,734.12	64,027.77
负债总额	66,694.57	39,658.86
其中:银行贷款总额	43,011.57	1,557.44
流动负债总额	66,694.57	39,658.86
归属于母公司所有者权益	20,039.54	24,368.91
或有事项涉及的总额	-	-
2025年1月至9月(未经审计)	192,147.88	160,412.71
营业收入	3,265.58	3,924.78
利润总额	2,724.21	3,278.39

9.芯斐科技不是失信被执行人,未受到失信惩戒

- (五)芯斐电子(香港)有限公司  
1.名称:芯斐电子(香港)有限公司  
2.住所:香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润物流沙田仓库4楼

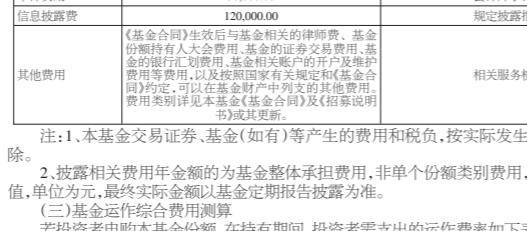
3.成立时间:2015年11月30日

4.主营业务:电子元件器件授权分销

5.法定代表人:陈辉军

6.注册资本:200万美元

7.与公司关系:芯斐电子为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:



8.主要财务指标:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	86,734.12	64,027.77
负债总额	66,694.57	39,658.86
其中:银行贷款总额	43,011.57	1,557.44
流动负债总额	66,694.57	39,658.86
归属于母公司所有者权益	20,039.54	24,368.91
或有事项涉及的总额	-	-
2025年1月至9月(未经审计)	192,147.88	160,412.71
营业收入	3,265.58	3,924.78
利润总额	2,724.21	3,278.39

9.香港联汇不是失信被执行人,未受到失信惩戒

- (六)芯斐科技(香港)有限公司  
1.名称:芯斐科技(香港)有限公司  
2.住所:香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润物流沙田仓库4楼

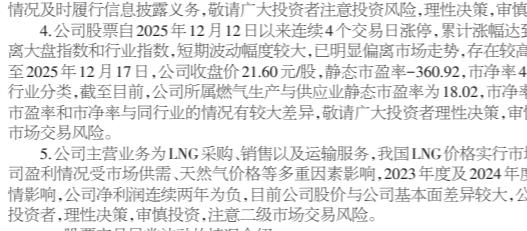
3.成立时间:2015年12月15日

4.主营业务:电子元件器件授权分销

5.法定代表人:陈辉军

6.注册资本:100万美元

7.与公司关系:芯斐科技(香港)为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:



8.主要财务指标:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	19	